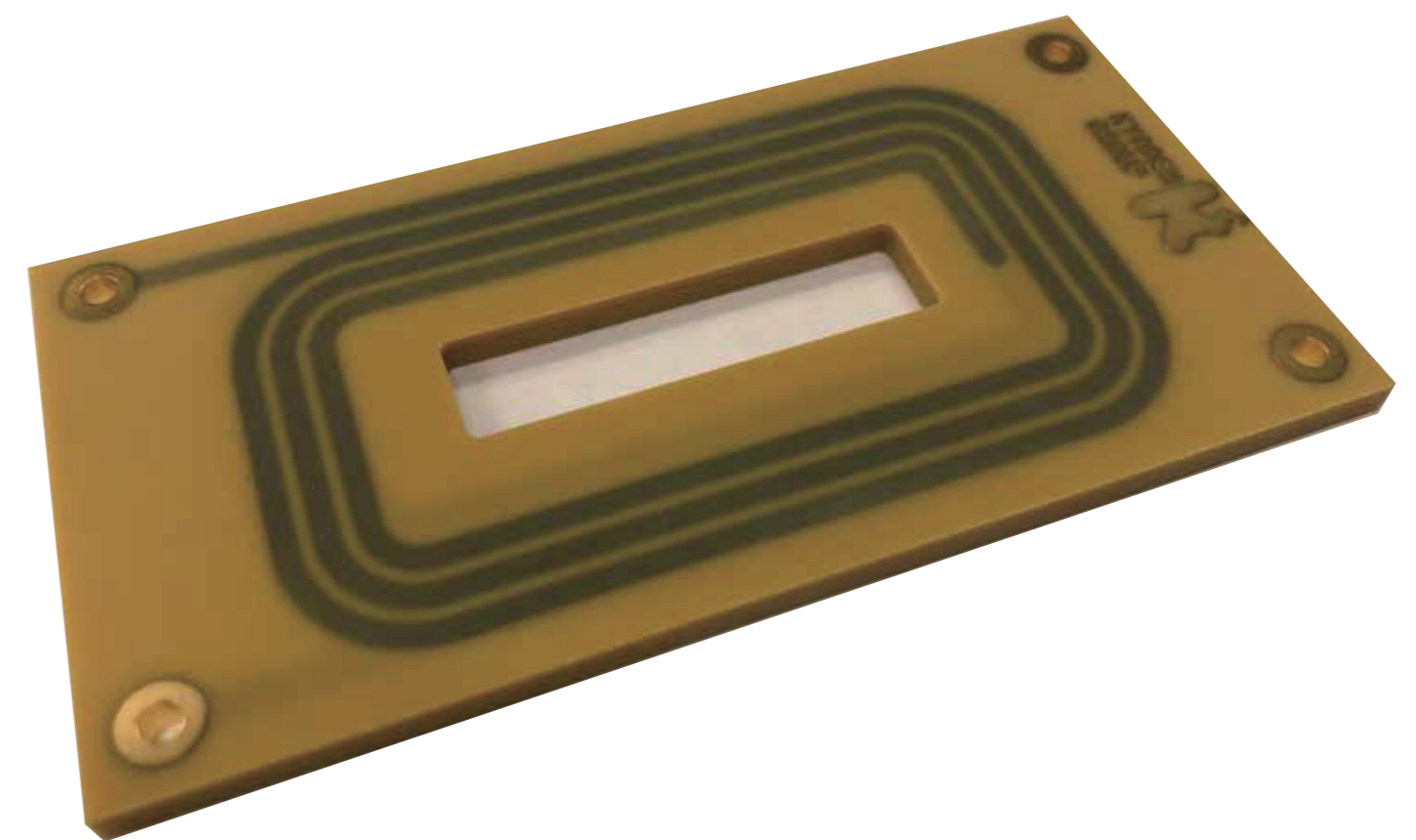
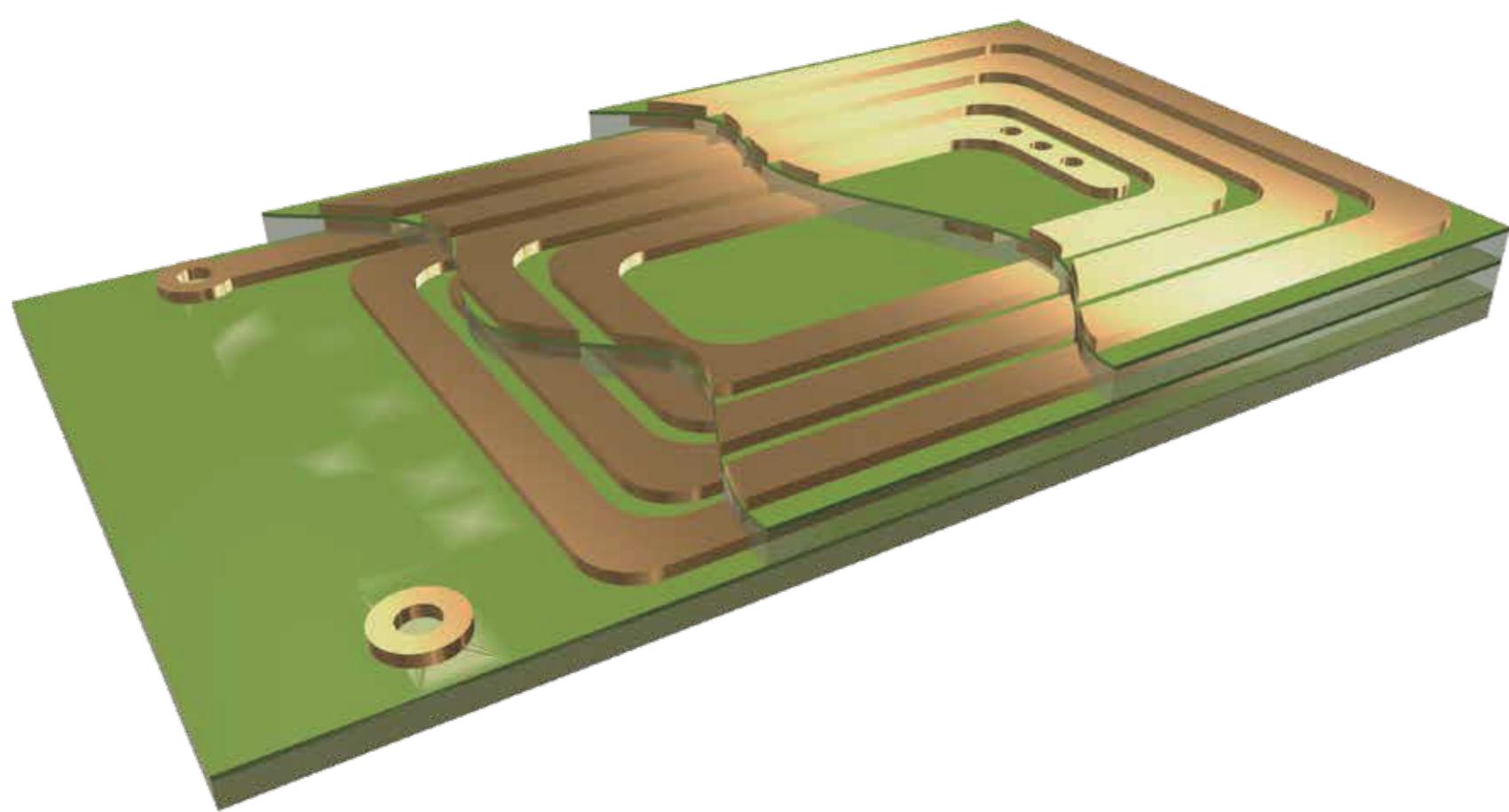


大電流・厚銅基板

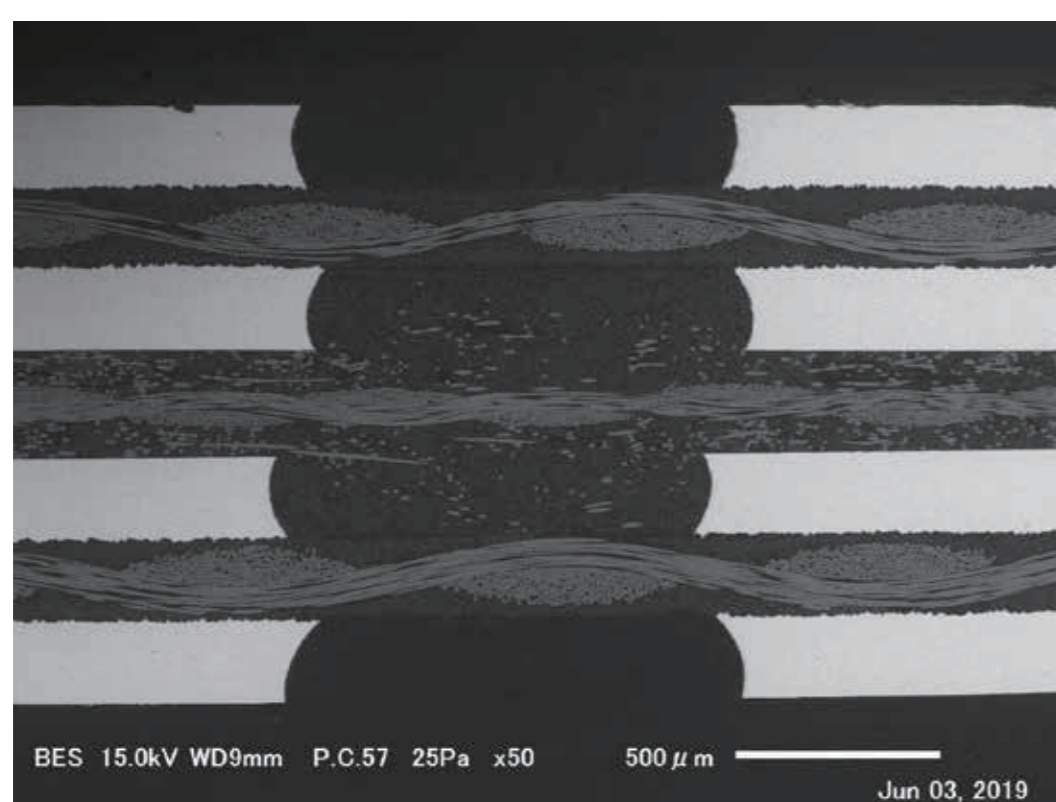
5G・自動化・電動化・ワイヤレス環境に貢献します

銅線からプリント基板への置き換えをお考えですか？



層構成 4層
◇厚銅箔:210μm

SPEC

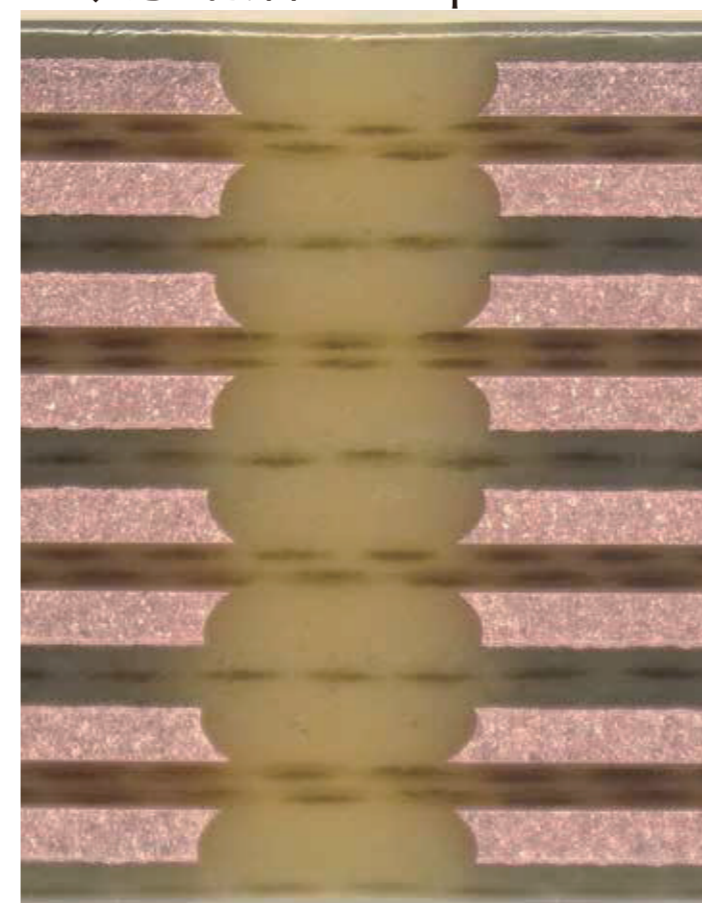


項目	実測値
210	197
L-6705C2	196
210	205
P-6725	225
P-6705	
P-6725	
210	200
L-6705C2	200
210	201
合計	1424

単位: μm

層構成 10層
◇厚銅箔:210μm

SPEC



項目	実測値
18 μ + 銅めっき	-
NPG-180BHB/NPG-180BM	159
210 μ	197
NPG-180BH 0.2	204
210 μ	190
NPG-180BM/NPG-180BHB/NPG-180BM	222
210 μ	195
NPG-180BH 0.2	198
210 μ	195
NPG-180BM/NPG-180BHB/NPG-180BM	239
210 μ	195
NPG-180BH 0.2	199
210 μ	197
NPG-180BM/NPG-180BHB/NPG-180BM	242
210 μ	195
NPG-180BH 0.2	199
210 μ	191
NPG-180BM/NPG-180BHB	162
18 μ + 銅めっき	-
合計	3379

※表層はTHランドのみ

◇厚銅を使用したいけど総板厚を薄くしたい → ご相談下さい！

◇インクジェット方式のマーキング採用により厚銅による高低差への追従も問題無し。

◇パターン間スペースは500μm～対応します。

◇伝送効率を考慮した設計をご提案します。